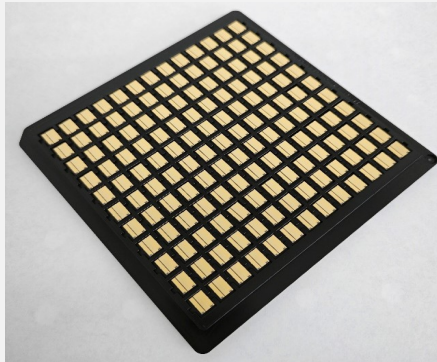




SiC 热沉

规格型号: DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-46



主要特性:

- 预制金锡焊料
- 单晶 SiC 基板, 热导率 $\geq 370\text{W/m}\cdot\text{K}$
- CTE 匹配芯片材料

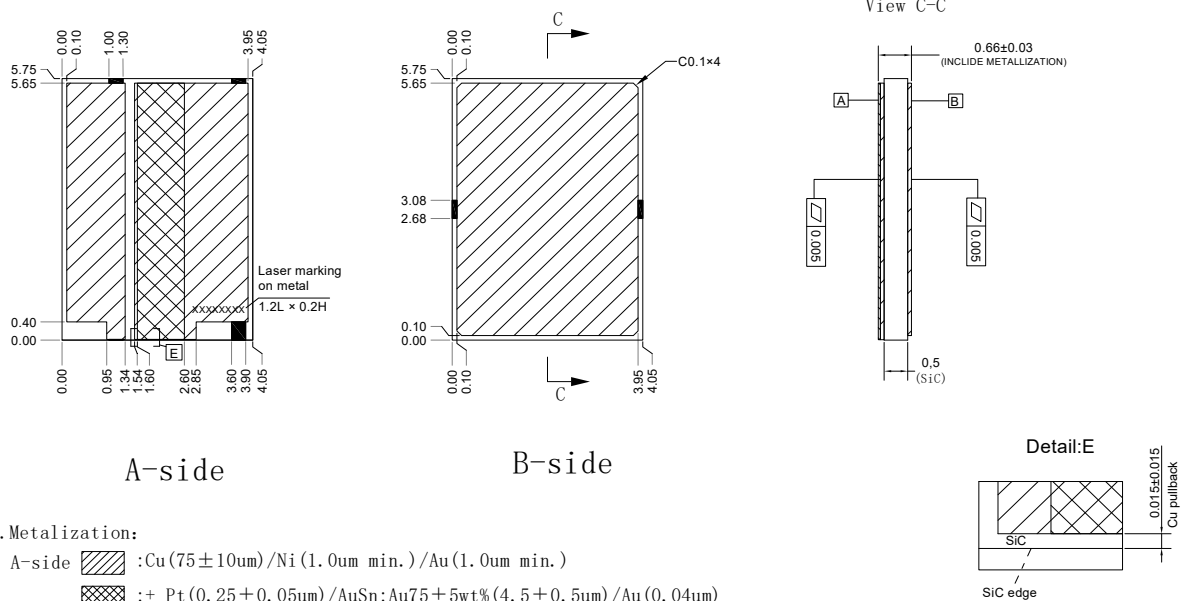


应用:

- 高功率激光芯片封装
- 科研与工程



详细图纸 (mm) :



1. Metalization:

- A-side: :Cu(75±10um)/Ni(1.0um min.)/Au(1.0um min.)
- :+ Pt(0.25±0.05um)/AuSn: Au75±5wt%(4.5±0.5um)/Au(0.04um)
- B-side: :Cu(75±10um)/Ni(1.0um min.)/Au(0.2um min.)
- Edge: :Thin film, Thickness $\leq 10\text{um}$

2. Other tolerance: $\pm 0.05\text{mm}$

3. A/B Surface Roughness: $R_a \leq 0.1\text{um}$

PARTS NAME	SiC Submount	DATE	2025-09-26
MODEL NAME	DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-46	SHEET	1/1
MATERIAL	SiC($\geq 370\text{W/m}\cdot\text{K}$)	DRAWN	
DIMENSION	4.05×5.75×0.66T	CHECKED	
UNIT	mm	APPROVED	

Dogain Optoelectronic Technology (Suzhou) Co., Ltd.

度亘保留所有权利。为保证产品的卓越品质和可靠性,产品规格和描述可能随时更新。了解具体产品详情,请与我们的销售代表联系获取。



度亘核芯光电技术(苏州)股份有限公司

地址:苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城39栋

电话:0512-6179 0076, 邮箱:sales@dogain.com, 网址:www.dogain.com

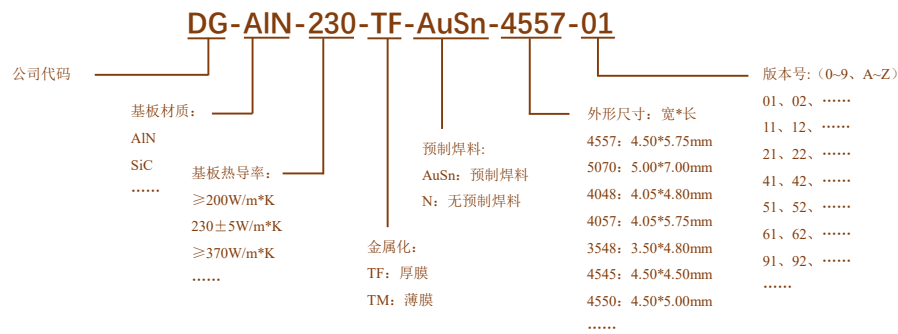


主要特征参数:

参数类别	单位	DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-46
长	mm	5.75±0.05
宽	mm	4.05±0.05
厚	mm	0.66±0.03
Cu pullback	mm	0.015±0.015
Cu 层厚度	um	75±10
Ni 层厚度	um	1.0 min.
Au 层厚度	um	A-side: 1.0min.、B-side: 0.2 min.
Au 层粗糙度	um	≤0.1
AuSn 层厚度	um	4.5±0.5
AuSn 组分	wt%	75±5(Au)
平面度	um	≤5
基板材质	\	单晶 SiC
基板热导率	W/m*K	≥370
存储环境	\	真空包装或氮气柜
存储温度	℃	25±15
存储湿度	%	≤60
保质期	年	1

备注:

- 1. 其他尺寸规格可定制;
- 2. 标准包装方式: 4 寸华夫盒装盘, 真空密封包装。
- 3. 规格型号说明:



度亘保留所有权利。为保证产品的卓越品质和可靠性，产品规格和描述可能随时更新。了解具体产品详情，请与我们的销售代表联系获取。



度亘核芯光电技术 (苏州) 股份有限公司
地址: 苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城39栋
电话: 0512-6179 0076, 邮箱: sales@dogain.com, 网址: www.dogain.com